



COMNEXT 2025 出展のご案内

この度、シンデン・ハイテックス株式会社は 2025 年 7 月 30 日（水）から 8 月 1 日（金）に東京ビッグサイトで開催される「COMNEXT 2025（次世代通信技術&ソリューション展）」に出展いたします。
今展示会では、弊社で取り扱っております各種無線通信製品および組み込みボード製品等の展示・デモを行い、ご要望に合わせた最適な製品・ソリューションの提案をさせていただく予定でございます。
是非とも弊社ブースにお越しいただきたく、下記来場登録 URL からご登録お願い申し上げます。

来場登録 URL >> <https://www.cbw-expo.jp/ja-jp/register.html?code=1389251651318885-JNA>

*事前にご来場日時を弊社担当者にお知らせいただければ幸いです。

— 展示会情報 —

- 会期：2025 年 7 月 30 日（水）～ 8 月 1 日（金）10:00-17:00
- 会場：東京ビッグサイト 南展示棟
- ブース番号：C10-6

— 出展予定製品 —

- ◆ [Telit Cinterion](#)：無線通信モジュール（5G, LTE, LPWA, BT/WiFi, GNSS）
- ◆ [MultiTech](#)：LoRaWAN ゲートウェイ・モジュール, LTE ルーター・モデム
- ◆ [IDY](#)：5G/LTE ゲートウェイ・ルーター
- ◆ [NEC プラットフォームズ](#)：AMD Embedded+（CPU+FPGA 統合プラットフォーム）
- ◆ [ASRock Industrial](#)：Jetson 搭載産業用 IoT コントローラー
- ◆ [iBASE](#)：最新 AMD Embedded Ryzen/EPYC 搭載マザーボード
- ◆ [ARBOR](#)：10 インチ堅牢型 Android タブレット



以上